

# Corporate Profile of DISCO



Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

UPDATE 2023.09.14.

# COMPANY HISTORY

Over 80 years of experience in abrasive technologies

- ✓ 1937年 – 1955年 창업~도쿄 진출
- ✓ 1956年 – 1974年 얇은 Blade를 운용할 수 있는 특화와 장치 개발에 대한 도전
- ✓ 1975年 – 1984年 정밀 가공 장치 제조업체로의 시작
- ✓ 1985年 – 1995年 글로벌 스탠다드 지향 체제
- ✓ 1996年 – 2003年 기업체질 강화
- ✓ 2004年 – 2011年 오오모리에서의 새로운 일보
- ✓ 2012年 – 2015年 새로운 미래상의 구현화
- ✓ 2016年 – 보다 가치있는 존재에게

- **1937年**  
경화 연마륜 제조회사 설립  
**Dai-Ichi Seitosh Co. Ltd.= DISCO**
- **1956年**  
일본최초의 초박형 레진로이드 슷돌완성  
(두께 0.13~0.14mm, 직경 100mm)
- **1969年**  
미국현지법인  
**DISCO ABRASIVE SYSTEM, INC.** 설립
- **1975年**  
**Blade Dicer** 모델 **DAD-2H**의 제조 및 판매 개시
- **1977年**  
상호를 주식회사 **DISCO**로 변경

- **1989年**  
주식을 일본증권협회에 장외등록
- **1999年**  
주식을 도쿄 증권거래소 제1부에 상장
- **2004年**  
본사/R&D센터를 도쿄 오오모리로 신축 이전
- **2008年**  
본사/R&D센터 B동 준공  
사업계속관리시스템 규격 인증취득 (BS2599-2:2007)  
폐수"제로화 " 실현하는 다이싱용 순수 재활용 장치 'DWR1720' 개발
- **2012年**  
정밀 가공 톨 제조 구레 공장에 C동 준공  
일본 최초 사업 지속 관리 시스템 규격 'ISO22301:2012' 인증 취득
- **2019年**  
쿠아바타공장 A동 C존 준공
- **2022年**  
하네다 R&D센타개설, 연구개발 기능 증강

# SOLUTIONS

## Evolution of Kiru

1956

140μm thickness



1968

40μm thickness



1975

First DISCO Dicer



1979

Automation



1989

First Dual Dicer



1993

Smallest manual dicer



Wafer size

Ø4"

Ø5"

Ø6"

Ø300  
(12")

1998 First 300mm Dicer

Ø8"



2000

Current dicing platform



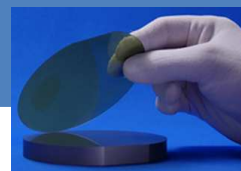
2018

Parallel Process Transferring System

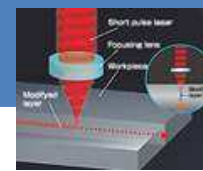


2017

Plasma dicing



2016  
KABRA



2007

Stealth Dicing



2006

WaterJet



2001

LASER Saw

# SOLUTIONS

Evolution of Kezuru • Migaku

1980

First DISCO  
Grinder

Creep-Feed



1984

In-Feed



1994

Space-saving  
+ Upgrading



2000

Current Grinding  
platform



2001

First DISCO  
Polisher



2003

Grinder +  
Polisher



2004

In-Line  
System



Wafer Size  
& Thickness

Ø4"  
400um

Ø6"  
400um

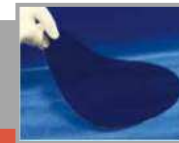
Ø8"  
100um

50µm

New concept system  
will be shown



5um



Ø8" & 12"  
30um

Ø12"  
50um



2006

Surface Planer

2019

Cluster System



2016

Large panel grinder



2012

High-level  
cleaning



2011

4 spindles,  
5 C/T



2010

TAIKO grinder



2009

CMP

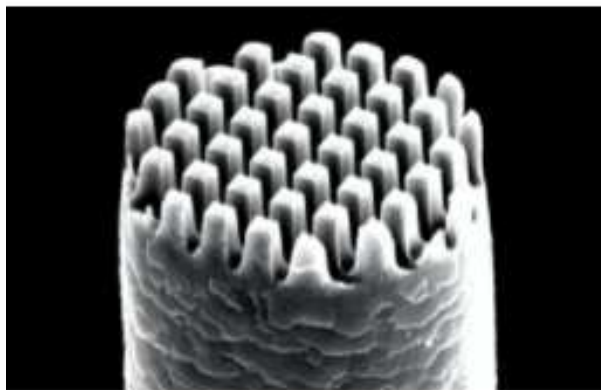




# DISCO의 Mission

「How to Do?」 그것은 **KKM**

작게 잘라 나누는 (Kiru)



머리카락의 단면을 35분할 할 정도의 섬세함

얇게 갈아 내는 (Kezuru)



Si t5um로 손이 비칠 정도의 투명함

경면 처럼 닦아내는 (Migaku)



거울 처럼 깨끗함

고도의 **Kiru·Kezuru·Migaku** 기술로 머나먼 과학을 밀접한 쾌적으로

기술의 진화에 의해서 날마다 편리하고 쾌적해지는 생활.

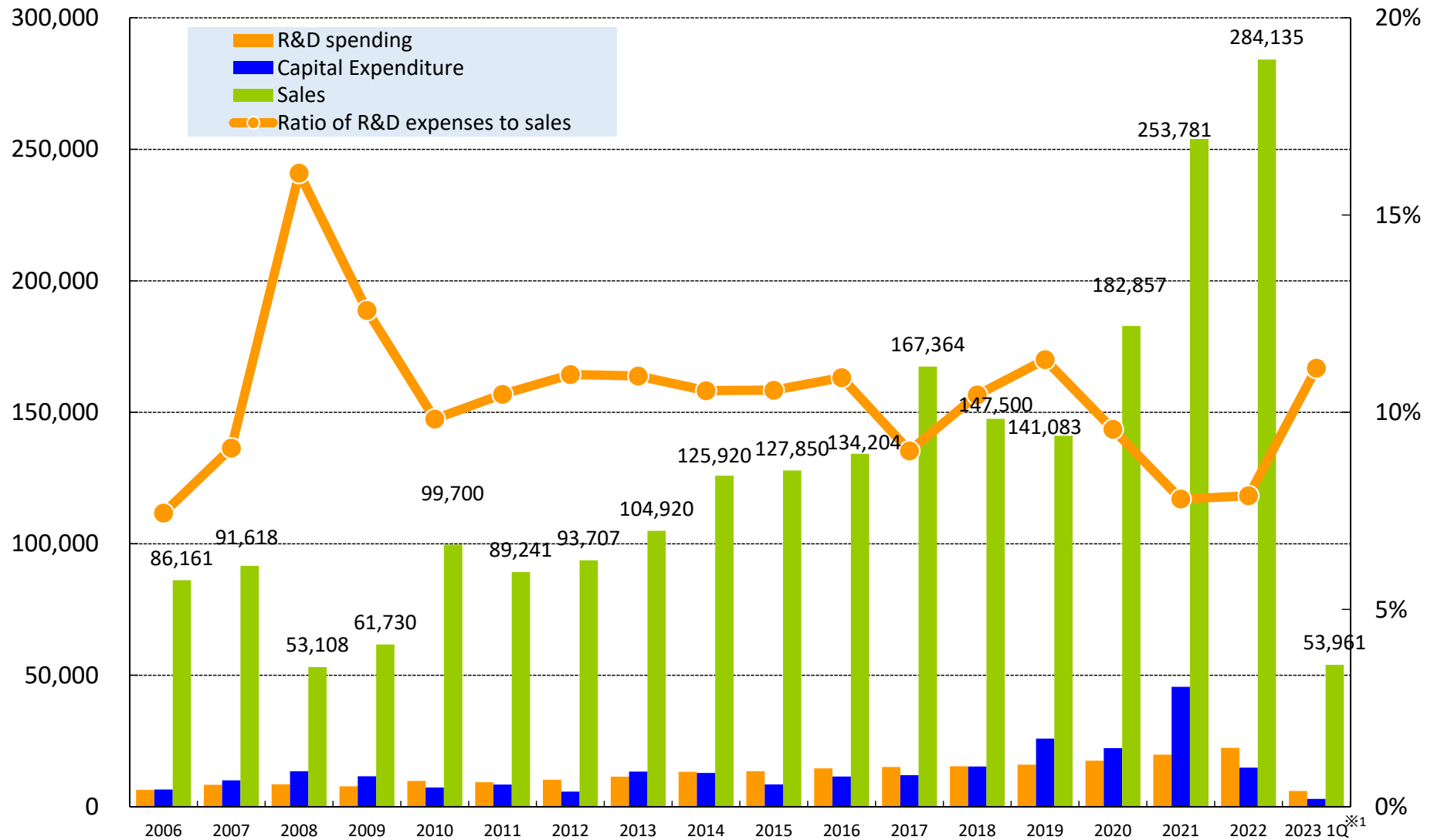
그 진화에 필수불가결한 반도체 제조에서 디스코 고도의 Kiru(절삭), Kezuru(연삭), Migaku(연마) 기술은 활용되고 있습니다. 일본어를 로마자로 표기하고 있는 것은

「일본어의 의미가 그대로 통용 될 정도의 세계 표준 레벨까지 디스코의 기술을 높이고 싶다」

그런 강한 마음으로부터 입니다.

여러분의 쾌적함에 계속 공헌 해 갈 수 있도록 디스코의 기술도 날마다 진화하고 있습니다.

# R&D and CAPITAL EXPENDITURE (Consolidated)



※1・・・The sales amount for FY2023 1Q is the actual result. R&D spending and capital expenditure were calculated by dividing the annual budget by four.

As of July, 2023

# SALES COMPOSITION

DISCO'의 강점은 장비와 소모품의 조합에 있습니다.

## Precision Processing Equipment 64%



Dicing Saw



Grinder



Grinder/Polisher + Tape Mounter\*

Note: Tape Mounter is an OEM supplied product included in "Others".

## Precision Processing Tools (Consumables) 22%



Dicing Blade

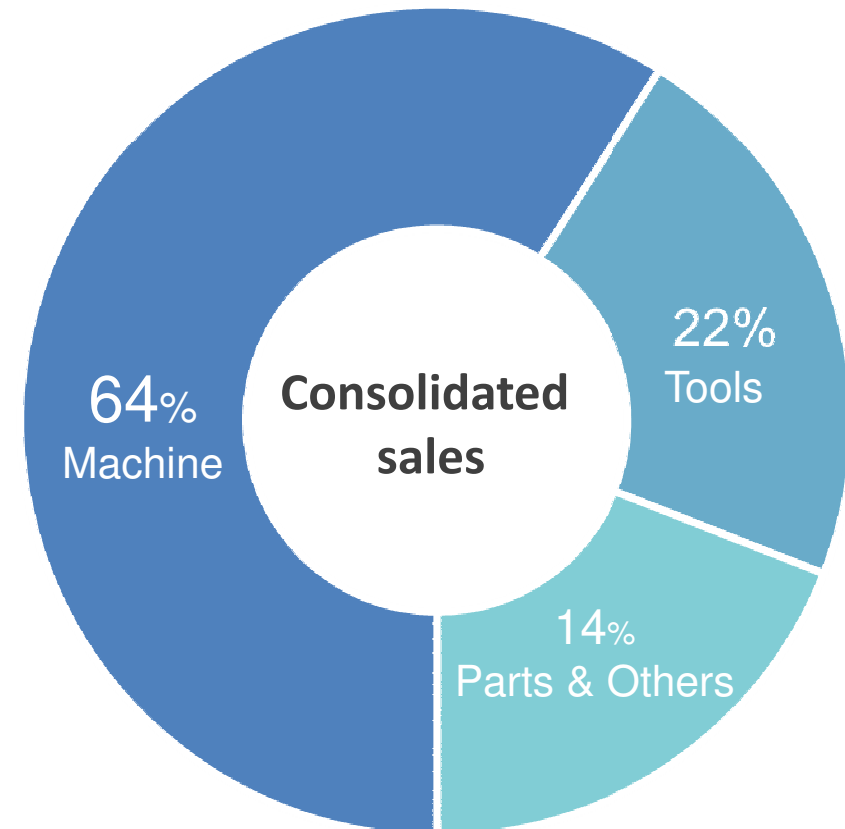


Grinding Wheel



Dry Polishing Wheel

## Parts, Service & Others 14%



As of April, 2023

# DISCO's WORLDWIDE NETWORK

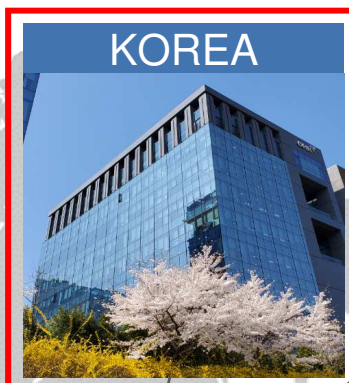
Cumulative sales  
over **62,590** units



EUROPE



CHINA



KOREA



JAPAN



TAIWAN









SINGAPORE

PHILIPPINES



AMERICA

-  DISCO office Sales, Maintenance, Applications Support
-  DISCO office Sales, Maintenance
-  DISCO office Sales Support, Maintenance, Application Support
-  Plant
-  Agent office
-  Affiliated company

**57 sites**  
Affiliate / Agent

**6,016**  
Employees  
※ Includes permanent/contract employees

As of April, 2023



# WORLDWIDE SUPPORT

DISCO 전세계적으로 지원이 가능합니다.

As of May, 2023

Office		DISCO HI-TEC KOREA	DISCO HI-TEC EUROPE		DISCO HI-TEC SINGAPORE	DISCO HI-TEC CHINA	DISCO HI-TEC TAIWAN	DISCO HI-TEC AMERICA
Location		Seoul	Germany, France, UK, Morocco		Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam	Shanghai	Taipei/Hsinchu/ Taichung/Tainan/ Kaohsiung	CA/NC/NM/MA/AZ/OR
Staff size	Sales	17	9		19	55	28	17
	AP	23	16		25	28	32	8
	CE	53	23		75	211	131	51
Tools for AP support, Grinding / Dicing Service		DAD3350 DFD6361 DWR1721 KWR1730 RAD3510 DAG810 DGP8761 LINTEC RAD3510 DFL7360 DGP8762 DFM9200 DDS2300 DFL7362sk	DPM2190X DTM300B DKL7440 DKS2240 DKG810 x2 DFX2400 DGP8761 DTM300B DFL7562 DGP8761CMP inline DFM2800 DFD6361 (HC) 2x DFG8540 inline Plasma DAG810 (x3) DGP8761 inline DFM2800 DGP8761 DGP8761 SiC Spec. DFG8340 DFP8140 DAS8920 DISCO Plasma DFS8910 DIS100 Mounter OKK DFD6560 DFD6341 x 2 DFD6340 x2 DFD6363(Sakasa) DCS1440 DAD3350 DWR1722	DFL7160 (DAF) 2x DFL7160 (Groover) DFL7340 (SD01) 2x DFL7341 (SD41) DFL7360FH (SD06) DFL7341LF (LEAF) DDS2010	DFD6341 DFD6361 DFD6755 DGP8761 DFL7360FH DDS2300 DIS100 EGT SVM Lintec RAD-3510 DWR1721x4	DAD3350(US) DAD3660*2 DAD323 DFD6361 DFD6361HC DFD6362 x2 DFD6362 HS(IR Camera & UV treatment) DFD6362RR DFD6363(ABC) DFL7161 DFL7161C DFL7562 DFL7362 DAG810 DGP8761+DFM2800 x2 DFG8640 DTG8460 DDS2310 DIS100 DWR1721 x8 DWR1722 x7 DTU1550 Lintec RAD2000 Nitto DR3000II Nitto MSA300II Lintec RAD3510 /12	DAD3661 DFD6361(HC/FC) DGP8761 +DFM2800 DWR1720 DWR1721 DCS1460 Lintec RAD3510 Lintec RAD2000 DFL7161 DIS100 Metrology Unit	DAD3240 DAD3350 DAD3360 DFD6341 DFD6360 DFD6362 DAG810 DGP8760 DGP8761 DFL7160 DFL7340 DFL7341 DFL7360FH DFL7361 DFM2700 DDS2010 DDS2020 DDS2300 DWR1720 DWR1721 DWR1722 DCS1440 DIS100 DAS8930 DTU162 KWR1730 Leaf TECDIA TEC-1228L Camtek Eagle-I Nanotronics nSPEC Sentronics Semdex OKK Expander OEX-800FD

# 일본의 사무실 및 공장

Chino, Nagano



Tokyo Head Office/R&DCenter



Kuwabata, Hiroshima



Kure, Hiroshima





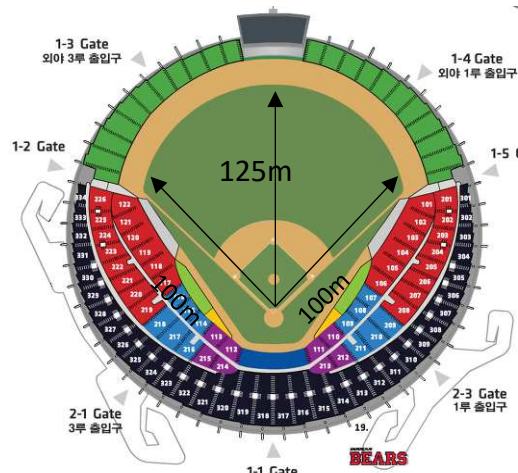
# HIROSHIMA WORKS

## KUWABATA 건설공사 준공 공장

신관건설의 목적 : 생산시스템 개선과 BCM의 추가적 개선



## Jamsil Baseball Stadium



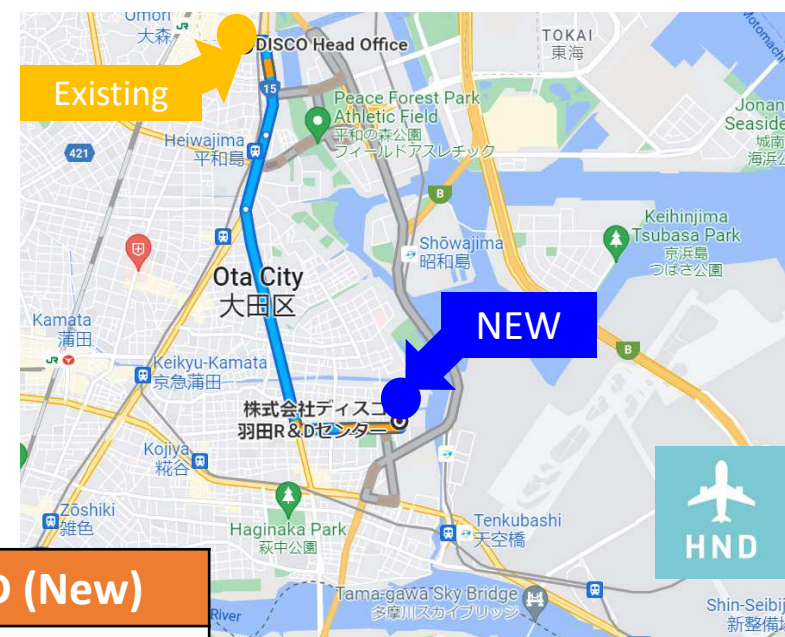
잠실야구경기장의 4배

## Facility



# DISCO Investment: Haneda R&D Center

DISCO has acquired new land and building to expand R&D and production facility  
DISCO Haneda R&D Center started operation from April 1, 2022



Site	Head Office, R&D	Haneda R&D (New)
Site area	11,570.54 m <sup>2</sup>	32,321.89 m <sup>2</sup>
Total floor space	52,760.27 m <sup>2</sup> (Buildings A and B combined)	63,008.53 m <sup>2</sup> 7 buildings in total

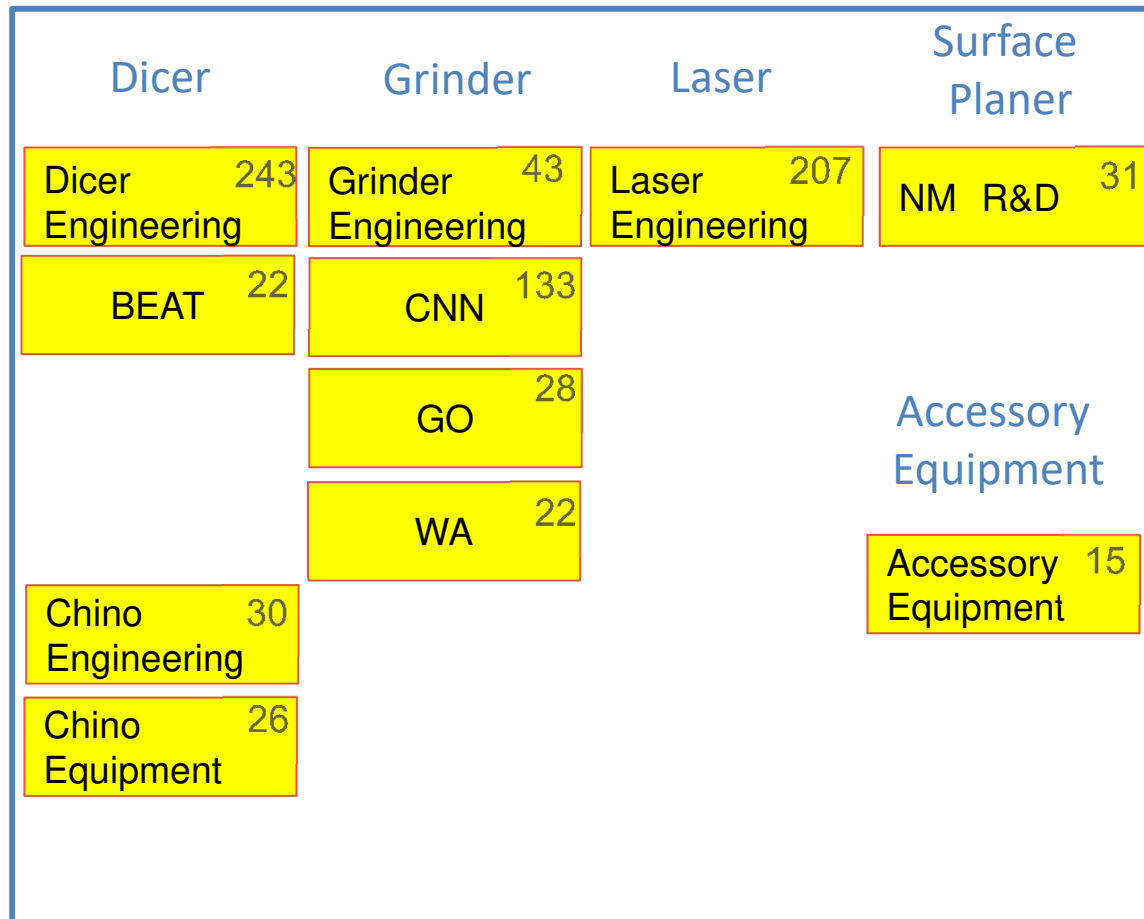




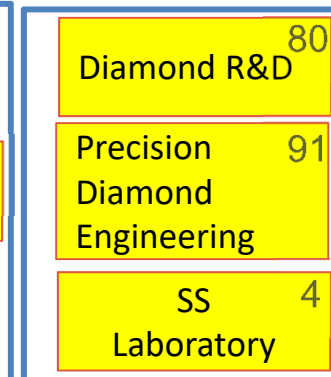
# DISCO R&D ORGANIZATION

## Engineering R&D Division

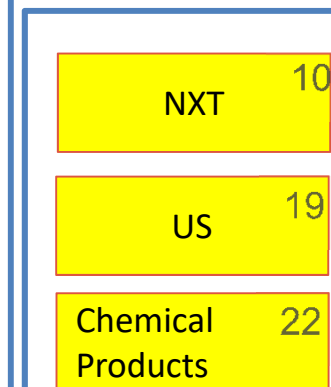
### Precision Processing Equipment



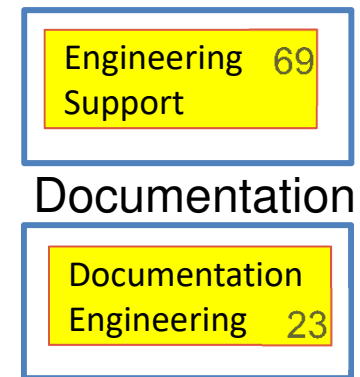
### Precision Diamond



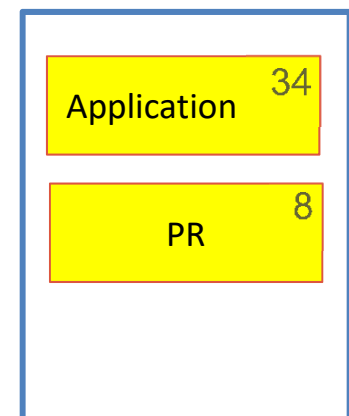
### Elemental Technology



### Support



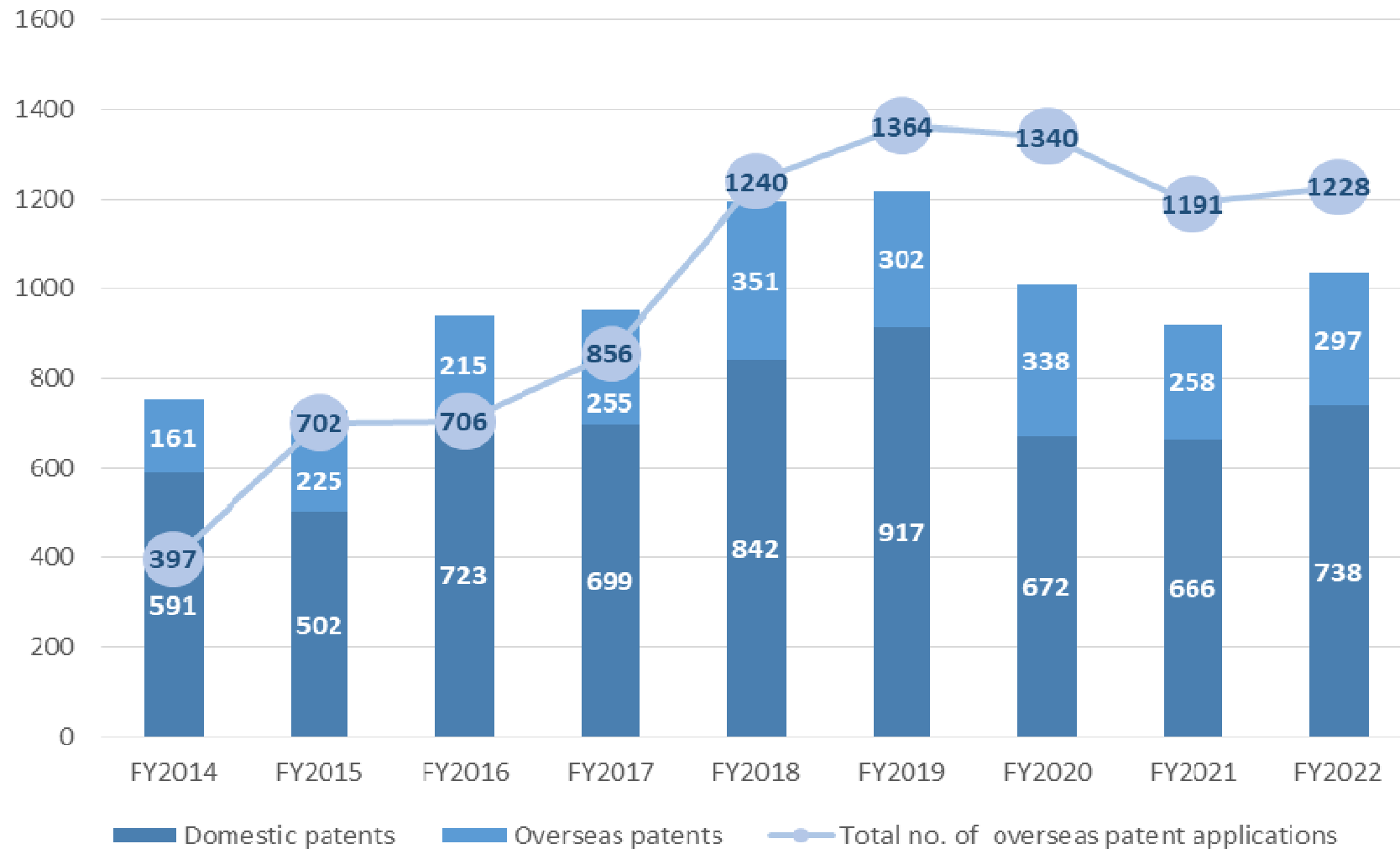
### Development of Processing Methods



As of May, 2023



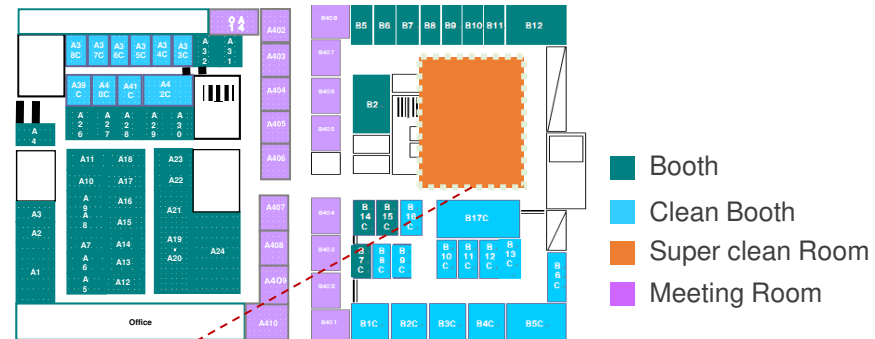
# About patent applications



As of April, 2023

# R&D APPLICATIONS LABORATORY

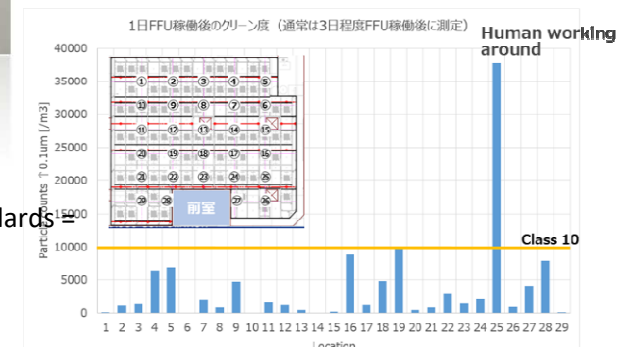
68 application booths including 24 clean booths and 1 super clean room



For clean dicing process development, DISCO is setting up a Class 10~100\* clean room in the applications laboratory (scheduled for completion at the end of July)



\*Class10-100 by United States standards  
Class 4-5 by ISO 14644-1 standards



As of June, 2023



# DISCO HI-TEC KOREA DHK SOLUTION



# DHK활동

## Semicon Korea&IMID 전시회



# DHK어필포인트



**2022대한민국 일하기 좋은 100대 기업**  
 2020働きがいのある会社(外資系部門)  
 2021年1月28日(木)  
 毎日経済新聞、韓国経済新聞に掲載

## 복리후생

### 사내식당

건강한 식단이 제공되는 사내식당을 운영 및 이용요금(식비) 지원

### 종합검진 예방접종

정기종합검진을 실시(1회/년) 및 예정접종 비용 지원  
 - 독감, A형, B형감염, 자궁경부암 등

### 휴양시설

국내/외 저렴하게 이용할 수 있는 고급 휴양시설 보유  
 -국내: 부산(숙박, 요트)  
 -해외: 오키나와, 나가노, 하와이 등



### 사원여행

매년 전사원이 함께하는 해외 및 국내 사원여행 실시  
 -2019년: 제주도  
 -2018년: 베트남 다낭  
 -2017년: 일본 홋카이도





**DISCO**  
Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



**Thank you**